



平成 29 年 12 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies
代表者名 代表取締役社長 方 永義
コード番号 3445 東証第一部
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 正行
電 話 03-5709-7685

資金の借入れに関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 11 日付の取締役会において、下記のとおり資金の借入れを行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入の理由

当社は、平成 29 年 12 月 1 日付「北京有色金属研究総院及び福建倉元投資有限公司との合弁会社設立による有研半導体材料有限公司の連結子会社化に関するお知らせ」に記載のとおり、中・長期的に中国の半導体市場に参入すべく、中国国内でプライムシリコンウェーハ事業の大手の 1 社である有研半導体材料有限公司（GRITEK）を当社が出資する北京有研RS半導体材料有限公司（BGRS）を通じて、連結子会社化することについてお知らせいたしております。

本件は BGRS 社への出資を目的とした借入金であります。

2. ローン契約の概要（予定）

(1) 借入先	株式会社 三井住友銀行
(2) 借入金額	40 億円
(3) 借入予定日	平成 30 年 1 月 10 日
(4) 資金用途	北京有研RS半導体材料有限公司（仮称） 設立に伴う出資金
(5) 融資期間	未定
(6) 担保の有無	無

3. 今後の見通し

本件による当社グループの平成 29 年 12 月期における連結業績に与える影響はありません。

以上